

Lagenaufbau

Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1	Cu+galv.Cu		18+25	
	Prepreg	0.068		1080
	Prepreg	0.068		1080
2	Cu	0.25	35	
	Tr-Lam		35	
	Cu		35	
3	Prepreg	0.068		1080
	Prepreg	0.068		1080
	Cu	0.25	35	
Tr-Lam	35			
Cu	35			
4	Prepreg	0.068		1080
	Prepreg	0.068		1080
	Cu	0.25	35	
Tr-Lam	35			
Cu	35			
5	Prepreg	0.068		1080
	Prepreg	0.068		1080
	Cu-Lam	0.25	35	
Tr-Lam	35			
Cu	35			
6	Prepreg	0.068		1080
	Prepreg	0.068		1080
	Cu	0.25	35	
Tr-Lam	35			
Cu	35			
7	Prepreg	0.068		1080
	Prepreg	0.068		1080
	Cu	0.25	35	
Tr-Lam	35			
Cu	35			
8	Prepreg	0.068		1080
	Prepreg	0.068		1080
	Cu+galv.Cu		18+25	

Presslingsdicke *	1,94	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske *	2,05	+/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 250 µm
	Viapad-Ø	≥ 550 µm
Leiterbild Außenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
	Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 175 µm
	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 190 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 240 µm
Leiterbild Innenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 85 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 100 µm